

2025 年 11 月

関連研究機関各位

HOYA Technosurgical 株式会社
東京都新宿区四谷 4-28-4
YKB エンサイビル
代表取締役社長 後藤哲一

奨学寄附等に代わる公募制の研究助成制度の導入について

謹啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社におきまして、2026 年度から、奨学寄附及び寄附講座に代わる公募制の研究助成制度を導入する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

従来は、各研究機関様の寄附金受入規程に基づき、弊社より、奨学寄附又は寄附講座の申し入れを行っておりましたが、今後は公募による研究機関様からのお申込み制とさせていただきます。申請いただきました研究につきましては、営業部門から独立した弊社寄附審査会にて公正かつ厳正に審査し、助成の可否や規模を決定させていただきます。申請書式や条件等の詳細につきましては弊社ウェブサイトにて 2026 年 3 月末日までにお知らせ申し上げます。

弊社は主に人工骨及び金属製インプラント領域における医療の発展を通じて患者様の QOL（生活の質）向上に貢献することを使命としており、今回導入される公募制の研究助成制度を通じて、同領域における研究を引き続き支援して参ります。

今後も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

公募開始	2026 年 4 月 1 日
詳細情報	弊社ウェブサイトにて、2026 年 3 月末日までに公開 https://www.hoyatechnosurgical.co.jp
本件に関する お問い合わせ窓口	HOYA Technosurgical 株式会社寄附審査会事務局 hots-donations@hoya.com

以上